

深圳证券交易所

关于对深圳市唯特偶新材料股份有限公司 的关注函

创业板关注函（2026）第 11 号

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会：

近期，你公司股价涨幅较大，5月20日触及严重异常波动，6月4日触及涨停。4月25日至5月21日，你公司路演频繁，共计发布7份投资者关系记录表，并多次在问答环节提及光模块、先进封装等热点领域相关业务。我部对此高度关注，请你公司核实说明以下事项：

1. 你公司主营业务为微电子焊接材料的研发、生产及销售。请你公司：

（1）说明公司所属行业当前竞争格局、资金及技术进入壁垒，公司在竞争中具有优劣势情况；结合公司最近一年一期经营情况，主要财务数据及其变动趋势、原因，主营产品目前销售领域、主要客户构成、所属领域、销售金额、毛利情况，与同行业可比公司是否存在显著差异。

(2) 说明截至目前公司主营产品微电子焊接材料与微电子辅助焊接材料（锡膏、锡条、锡线、助焊剂、清洗剂等）主要直接及间接客户、产能及产能利用率、月度产销量、月度销售额、在手订单、具体用途等情况，是否较前期披露信息发生较大变化，相关变化对公司经营业绩产生的具体影响，并充分提示相关风险。

2. 你公司在上述期间内发布的 7 份投资者关系记录表中，6 份提及公司产品在光模块领域相关应用，称“在光模块及其部件的生产过程中，锡膏主要应用于三大环节：一是光器件的 SMT 贴装，二是光芯片封装中的高精度倒装焊，三是 PCBA 上其他无源元件的表面贴装。公司的微电子焊接材料等产品可应用于上述应用场景”。请你公司：

(1) 说明光模块生产商在光模块及其部件生产过程中各环节所需使用锡膏的含量，对应单价及金额、占光模块产品价格的比例；

(2) 结合对问题 1 的答复，说明公司目前主营产品分别应用在光模块生产三大环节的具体情况，包括各环节对应的主要客户名称、最近一年及一期已实现的销售金额、毛利率、在手订单金额。

3. 你公司在上述期间内发布的 7 份投资者关系记录表中，2 份提及公司产品在先进封装领域相关应用，称公司生产的微电子焊接材料“主要应用于 PCBA 制程、精密结构件连接、半导体封装等多个产业环节的电子器件的组装与互联”，公司将“推进激光锡膏、超细粉锡膏等产品在先进半导体封装

等新兴领域的渗透应用，为业务增长提供技术支撑”。请你公司：

(1) 说明半导体封装过程中各环节所需使用锡膏的含量，对应单价及金额、占终端产品价格的比例；

(2) 结合对问题 1 的答复，说明公司目前主营产品分别应用在先进封装各环节的具体情况，包括各环节对应的客户名称、最近一年及一期已实现的销售金额、毛利率、在手订单金额。

4. 你公司在上述期间内发布的 7 份投资者关系记录表中，2 份提及通讯、显示与照明、家电、光伏、汽车电子、消费电子等多家热点头部企业及多家国际知名终端品牌客户。请你公司说明最近一年一期你公司与通讯、显示与照明、家电、光伏、汽车电子、消费电子等多家热点头部企业及多家国际知名终端品牌客户交易金额及收入、毛利占比，相关头部企业对公司经营业绩的贡献。

5. 请你公司自查并列示公司近期接受媒体采访、机构和投资者调研、回复投资者咨询等情况，说明是否存在违反信息披露公平性原则的情形；并进一步说明公司在上述期间多次开展特定对象调研、路演活动等投资者关系活动的具体考虑、方案设计的具体职能部门，履行的内部程序、审批人员，较此前次数、频率均显著增加的原因及合理性，光模块应用、先进封装领域应用的提问人员。

6. 请你公司说明近期经营情况及内外部经营环境是否发生重大变化，核实是否存在筹划中的重大事项，是否存在

其他应披露未披露信息，是否存在其他对公司股票交易价格可能产生较大影响的市场传闻、热点概念等，前期信息披露是否存在需补充或更正情形。

7. 你公司认为应予说明的其他事项。

请你公司就上述事项做出书面说明，在 2026 年 6 月 7 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送深圳证监局上市公司监管处。

我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

特此函告。

深圳证券交易所
创业板公司管理部
2026 年 6 月 4 日